



H2560 导电屏蔽胶

H2560 是一款柔软的就地成型的单组份室温固化导电粘结剂，具有增强承载能力和抗冲击能力的特性。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	有机硅
组分	单组分
填料成份	Ag/Al
固化方式	室温固化
应用	汽车传感器的焊接和电磁干扰、射频屏蔽盒的垫圈

产品优点

- 单组份，室温固化
- 柔软
- 抗冲击

产品性能

条目	典型值	备注
外观	褐色液体	-
比重 g/ml	3.05~3.3	GB/T 13354 @25°C
粘度 mPa·s	50000	GB/T 2794 @25°C
25°C/50%±5%相对湿度下固化 72 小时		
硬度 shore A	56	GB/T 531.1
抗拉强度 N/mm ²	≥0.7	GB/T 528
断裂延伸率%	≥40	GB/T 528
搭接剪切强度 N/mm ²	1.0	GB/T 7124
体积电阻率 Ω·cm	≤0.01	GB/T 1692



使用方法

1. 产品在放置前应置于室温下使用；
2. 为获得最佳性能，粘接表面应清洁并无油脂；
3. 完整的性能特性将在 72 小时内形成；
4. 暴露在大气中湿气固化在产品放置后立即开始，因此零件应在点胶后几分钟内进行粘接；
5. 多余的胶粘剂可以用溶剂很轻松地擦掉。

注：不建议将 H2560 用作就地固化的垫圈(在组装前固化)。

标准包装

- 10g / 支
- 按客户需求包装

产品储存

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：2-8°C，存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com